PCT/JP2005/008145

10/594567

明細書

化学気相成長用原料及び薄膜の製造方法 技術分野

[0001] 本発明は、金属化合物からなるプレカーサを含有してなり、原料液相中のパーティクルを低減させた化学気相成長用原料、及びこれを用いた薄膜の製造方法に関する。

背景技術

- [0002] 金属原子からなる薄膜又は金属原子を含有してなる薄膜は、電極、高誘電体キャパシタ、強誘電体キャパシタ、ゲート絶縁膜、バリア膜等の電子部品や、光導波路、 光増幅、光スイッチ等の光通信部品の部材として用いられている。
- [0003] 上記の薄膜の製造法としては、組成制御性及び段差被覆性に優れること、量産化に適すること、ハイブリッド集積が可能である等多くの長所を有しているので、ALD(Atomic Layer Deposition)法を含む化学気相成長(以下、単にCVDと記載することもある)法が最適な製造プロセスである。また、CVD法に使用される原料は、CVD法の工程内において液相で輸送又は供給できるものが、プロセスのコントロール、メンテナンス等が容易である。
- [0004] 金属アルコキシド化合物、金属アミド化合物、β ジケトン金属錯体、アルキル金属化合物等の高分解性又は高加水分解性の金属化合物からなるプレカーサを用いたCVD法は、得られる薄膜のパーティクル汚染の問題を有しており、これを低減化するための方法が、例えば特許文献1~4に報告されている。特許文献1には、トリメチルビニルシリルへキサフルオロアセチルアセトン飼又はテトラキスジメチルアミノチタンを用いた液体CVD法において、パージガスラインと反応器をパージガス導入機構部により連結する方法が報告されている。また、特許文献2には、タンタルとチタニウムの複合酸化物薄膜の製造において、プレカーサを混合した複合アルコキシドを用いる方法が報告されている。また、特許文献3には、珪素とハフニウムの複合酸化物又は珪素とジルコニウムの複合酸化物の製造において、珪素アルコキシドとハフニウムアルコキシド又はジルコニウムアルコキシドとの混合物を用いる方法が記載され

ている。また、引用文献4には、酸化タンタルの製造方法において、タンタルアルコキシド中の不純物塩素を低減する方法が記載されている。

- [0005] 上記の特許文献1に記載の方法は、CVD装置の工夫によりパーティクルの発生を 抑制するものであり、特許文献2及び3それぞれに記載の方法は、複合原料を用いる ことで化学反応によるパーティクルを抑制するものであり、特許文献4に記載の方法 は、原料中の不純物成分を低減することで不純物由来のパーティクルを抑制するも のである。これらはいずれも、CVDプロセス中で発生するパーティクルを抑制する方 法である。
- [0006] パーティクル汚染を抑制する方法としては、使用薬剤中のパーティクルを低減する 手法が有効であり、ライン洗浄、プレカーサ溶媒に用いられる有機溶剤や、テトラエ チルシリケート(TEOS)等の低分解性のプレカーサ化合物については、パーティク ルを低減したものが提供されている。しかし、高分解性の金属化合物をプレカーサに 用いたCVD用原料については、プレカーサ自体が、貯蔵容器、充填装置等の装置 部材、キャリアガス、溶媒等に含まれる微量水分によりパーティクルを生成してしまう ので、パーティクルを低減したものはなかった。
- [0007] 特許文献1:特開平9-302471号公報

特許文献2:特開2002-53504号公報

特許文献3:特開2002-53960号公報

特許文献4:特開平9-121027号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0008] 従って、本発明の目的は、高分解性の金属化合物をプレカーサに用いたCVD用原料であり、薄膜のパーティクル汚染を低減できるものを提供することにある。 課題を解決するための手段
- [0009] 本発明者等は、検討を重ねた結果、高分解性の金属化合物をプレカーサとしたC VD用原料中のパーティクルを低減することにより、薄膜のパーティクル汚染を抑制し 得ることを知見した。本発明者等は、この知見に基づき更に検討を重ねた結果、特定 の粒子径のパーティクルを特定の数以下に低減したCVD用原料が、パーティクル汚

染の抑制に効果があり、上記目的を達成し得ることを知見した。

[0010] 本発明は、上記知見に基づきなされたもので、金属化合物からなるプレカーサを含有してなり、液相での光散乱式液中粒子検出器によるパーティクル測定における0. 5 μ mより大きい粒子の数が1ml中100個以下である化学気相成長(CVD)用原料、及び該CVD原料を用いた化学気相成長法による金属含有薄膜の製造方法を提供するものである。

図面の簡単な説明

[0011] [図1]本発明のCVD用原料の製造に用いられる製造装置の一例を示す概要図である。

[図2]本発明のCVD用原料のパーティクル測定に用いられる光散乱式液中粒子測定装置の一例を示す概要図である。

[図3]本発明の金属含有薄膜の製造方法に用いられるCVD装置の一例を示す概要 図である。

発明を実施するための最良の形態

- [0012] 本発明に係るプレカーサである金属化合物を構成する金属原子は、特に制限されるものではなく、金属、合金、金属酸化物、複合金属酸化物、金属窒化物、複合金属窒化物、金属炭化物、複合金属炭化物又はこれらの2種類以上の混合物等の薄膜を所望の組成で構成できるように、任意の金属原子を選択することができる。
- [0013] 上記の金属原子としては、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム等の1族元素、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム等の2族元素、スカンジウム、イットリウム、ランタノイド元素(ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウム)、アクチノイド元素等の3族元素、チタニウム、ジルコニウム、ハフニウムの4族元素、バナジウム、ニオブ、タンタルの5族元素、クロム、モリブデン、タングステンの6族元素、マンガン、テクネチウム、レニウムの7族元素、鉄、ルテニウム、オスミウムの8族元素、コバルト、ロジウム、イリジウムの9族元素、ニッケル、パラジウム、白金の10族元素、銅、銀、金の11族元素、亜鉛、カドミウム、水銀の12族元素、アルミニウム、ガリウム、インジウム、タ

リウムの13族元素、ゲルマニウム、錫、鉛の14族元素、砒素、アンチモン、ビスマスの 15族元素、ポロニウムの16族元素が挙げられる。

- 上記の金属原子と結合し金属化合物を構成する配位子としては、塩素、臭素、ヨウ [0014] 素等のハロゲン化物;アルカン類;モノアルキルアミン類;ジアルキルアミン類;トリメチ ルシリルアミン、トリエチルシリルアミン等のシリルアミン類;メタンイミン、エタンイミン、 プロパンイミン、2ープロパンイミン、ブタンイミン、2ーブタンイミン、イソブタンイミン、 第三ブタンイミン、ペンタンイミン、第三ペンタンイミン等のアルカンイミン類;シクロペ ンタジエン類;モノアルコール、ジオール等のアルコール類;アセチルアセトン、ヘキ サン-2, 4-ジオン、5-メチルヘキサン-2, 4-ジオン、ヘプタン-2, 4-ジオン 、2-メチルヘプタン-3、5-ジオン、5-メチルヘプタン-2,4-ジオン、6-メチ ルヘプタン-2,4-ジオン、2,2-ジメチルヘプタン-3,5-ジオン、2,6-ジメチ 6ーテトラメチルヘプタンー3, 5ージオン、オクタンー2, 4ージオン、2, 2, 6ートリメ チルオクタン-3,5-ジオン、2,6-ジメチルオクタン-3,5-ジオン、2,9-ジメ チルノナン-4,6-ジオン2-メチル-6-エチルデカン-3,5-ジオン、2,2-ジ メチルー6ーエチルデカンー3,5ージオン、1,1,1ートリフルオロペンタンー2,4ー ジオン、1、1、1ートリフルオロー5、5ージメチルヘキサンー2、4ージオン、1、1、1、 5. 5. 5ーヘキサフルオロペンタンー2. 4ージオン、1, 3ージパーフルオロヘキシル プロパンー1.3ージオン、1.1.5、5ーテトラメチルー1ーメトキシヘキサンー2、4ー ジオン、2, 2, 6, 6ーテトラメチルー1ーメトキシヘプタンー3, 5ージオン、2, 2, 6, 6 ーテトラメチルー1ー(2ーメトキシエトキシ)ヘプタンー3, 5ージオン等のβージケトン 類:アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、アセト酢酸ブチル、アセト酢酸-2メトキシ エチル等の 8 ーケトエステル類等が挙げられ、これらは1種類が金属原子に結合して もよく、2種類以上が結合していてもよい。
- [0015] 上記の金属化合物の中でも、高分解性又は高加水分解性であるが故にパーティクル汚染の問題が顕著に現れているものとしては、下記一般式(I)又は(II)で表される基を誘導するアルコール化合物、有機アミン化合物又は炭化水素化合物を配位子に用いた、金属アルコキシド化合物、金属アミド化合物、アルキル金属化合物及びシ

WO 2005/116292 5 PCT/JP2005/008145

クロペンタジエン錯体が挙げられるが、本発明のCVD用原料は、これらの金属化合物をプレカーサとして用いた場合にも、パーティクル汚染が発生するのを防止することができる。また、これらの配位子を用いたプレカーサで特に有用である金属化合物としては、アルミニウム化合物、チタニウム化合物、ジルコニウム化合物、ハフニウム化合物、タンタル化合物及びニオブ化合物が挙げられる。

[0016] [化1]

$$-\frac{R^{1}}{X-(-R^{2})_{D}}$$
 (1)

(式中、Xは、酸素原子又は窒素原子を表し、nは、Xが酸素原子の場合は0を表し、Xが窒素原子の場合は1を表し、R1は、炭素数 $1\sim10$ の有機基を表し、R2は、水素原子又は炭素数 $1\sim10$ の有機基を表す。)

[0017] [化2]

$$-\mathbb{R}^3 \qquad (11)$$

(式中、 R^3 は、炭素数 $1 \sim 8$ のアルキル基又は炭素数 $1 \sim 1$ 0 のシクロペンタジエニル基を表す)

[0018] 上記一般式(I)において、R¹及びR²で表される炭素数1~10の有機基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第二ブチル、第三ブチル、イソブチル、アミル、イソアミル、第二アミル、第三アミル、ヘキシル、3ーメチルペンタンー3ーイル、ヘプチル、3ーヘプチル、イソヘプチル、第三ヘプチル、nーオクチル、イソオクチル、第三オクチル、2ーエチルヘキシル、ノニル、デシル、シクロペンチル、シクロヘキシル、メチルシクロヘキシル、フェニル、メチルフェニル、エチルフェニル、ベンジル等の炭化水素基;2ーメトキシエチル、2ーエトキシエチル、2ーブトキシエチル、2ー(2ーメトキシー1,1ージメチルエチル、2ーオトキシー1,1ージメチルエチル、2ーオトキシー1,1ージメチルエチル、2ーオトキシー1,1ージメチルエチル、2ーオトキシー1,1ージメチルエチル、2ーオトキシー1,1ージメチルエチル、2ーオトキシー1,1ージメチルエチル、2ーオトキシー1,1ージメチルエチル、2ーオトキシー1,1ージメチルエチル、2ーオトキシー1,1ージメチルエチル、2ーオトキシー1,1ージメチルエチル、2ープトキシー1,1ージメチルエチル、2ーイソプロポキシー1,1ージメチルエチル、2ープトキシー1,1ージメチルエチル、2ー(2ーメトキシエトキシ)-1,1ージメチルエチ

ル等のエーテルアルキル基;トリフルオロメチル、1, 1, 1ートリフルオロエチル、ペンタオロエチル等のフッ化アルキル基;2ー(ジメチルアミノ)エチル、2ー(ジエチルアミノ)エチル、2ー(ジエチルアミノ)プロピル、2ー(ジメチルアミノ)プロピル、2ー(ジメチルアミノ)ー1ーメチルエチル、2ー(ジメチルアミノ)ー1ーメチルエチル、2ー(ジメチルアミノ)ー1, 1ージメチルエチル、2ー(ジエチルアミノ)ー1, 1ージメチルエチル、2ー(エチルメチルアミノ)ー1, 1ージメチルエチル、2ー(エチルメチルアミノ)ー1, 1ージメチルエチル。

- [0019] また、上記一般式(I)で表される基を有する金属化合物は、金属原子に少なくとも1個の一般式(I)で表される基が結合したものであり、配位し得る全ての数が配位したものが一般的に使用される。また、モノメリックな金属アルコキシド化合物、金属アミド化合物でもよく、ダブルアルコキシドのような複合金属化合物でもよい。また、これらは位置異性体や光学異性体により区別されることはない。さらに、R¹又はR²の末端がジアルキルアミノ基やアルコキシ基のような電子供与性基の場合は、該電子供与基が金属原子に配位していてもよい。尚、本発明では、便宜上、このような電子供与基は、金属原子に配位していない形で代表して表す。
- [0020] 本発明に係る上記一般式(II)において、R³で表される炭素数1~8のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第二ブチル、第三ブチル、イソブチル、アミル、イソアミル、第二アミル、第三アミル、ヘキシル、ヘプチル、3ーへプチル、イソヘプチル、第三ヘプチル、nーオクチル、イソオクチル、第三オクチル、2ーエチルへキシル等が挙げられ、炭素数1~10のシクロペンタジエニル基としては、シクロペンタジエニル、メチルシクロペンタジエニル、エチルシクロペンタジエニル、プロピルシクロペンタジエニル、イソプロピルシクロペンタジエニル、ブチルシクロペンタジエニル、メチルシクロペンタジエニル、ブチルシクロペンタジエニル、メチルシクロペンタジエニル、ポンタメチルシクロペンタジエニル等が挙げられる。
- [0021] 本発明に係るプレカーサとして用いることができるアルミニウム化合物としては、例 えば下記一般式(III)又は(IV)で表される化合物が挙げられる。

[0022] [化3]

$$\left(H^{-}\right)_{3}$$
 Al·L (III) $\left(H^{-}\right)_{0}$ Al· $\left(-R^{1}\right)_{3-q}$ (IV)

(式中、Lは、窒素原子又は酸素原子を有する5~6員環の配位性複素環化合物を表し、R'は、炭素数1~4のアルキル基を表し、q'は0~2の整数を表す。)

- [0023] 上記一般式(III)において、Lで表される配位性複素環状化合物としては、18-クラウン-6、ジシクロヘキシル-18-クラウン-6、24-クラウン-8、ジシクロヘキシル-24-クラウン-8、ジベング-24-クラウン-8等のクラウンエーテル類;サイクラム、サイクレン等の環状ポリアミン類;ピリジン、ピロリジン、ピペリジン、モルホリン、N-メチルピロリジン、N-メチルピペリジン、N-メチルモルホリン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、1、4-ジオキサン、オキサゾール、チアゾール、オキサチオラン等が挙げられる。また、上記一般式(IV)において、R'で表される炭素数1~4のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第2ブチル、第3ブチル、イソブチル等が挙げられる。上記一般式(III)又は(IV)で表される化合物の具体例としては、トリメチルアルミニウム、N-メチルピロリジニルアラン等が挙げられる。
- [0024] 本発明に係るプレカーサとして用いることができるチタニウム化合物、ジルコニウム 化合物及びハフニウム化合物としては、例えば下記一般式(V)又は(VI)で表される 化合物が挙げられる。

[0025] [化4]

$$\begin{pmatrix} R^{R} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

(式中、R *及びR bは炭素数 $1\sim 10$ の有機基を表し、 M^1 はチタニウム、ジルコニウム又はハフニウムを表し、 R^1 及び R^2 は上記一般式(I)と同様の基を表し、xは 1、 2 、 3 又は 4 を表す。)

[0026] 上記一般式(V)において、R⁶及びR⁶で表される炭素数1~10の有機基としては、 上記一般式(I)のR¹で例示の基が挙げられる。上記一般式(V)で表される化合物の 具体例としては、下記化合物No. 1~39が挙げられる。

[0027] [化5]

[0028] [化6]

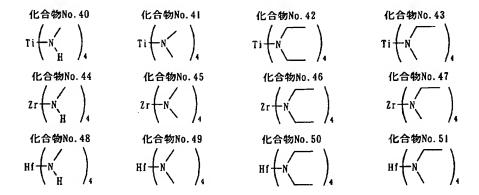
[0029] [化7]

[0030] [化8]

[0031] [化9]

[0032] [化10]

[0033] 上記一般式(VI)で表される化合物の具体例としては、下記化合物No. 40~51が 挙げられる。 [0034] [化11]



[0035] 本発明に係るプレカーサとして用いることができるタンタル化合物及びニオブ化合物としては、例えば下記一般式(VII)又は(VIII)で表される化合物が挙げられる。

[0036] [化12]

$$\left(\begin{array}{c} R^{2} \\ \end{array}\right)_{5-y} M^{2} \left(\begin{array}{c} 0 \\ \end{array}\right)_{y} \qquad (VIII) \qquad \left(\begin{array}{c} R^{c} \\ \end{array}\right)_{z} M^{2} \left(\begin{array}{c} R^{1} \\ \end{array}\right)_{5-2z} \qquad (VIIII)$$

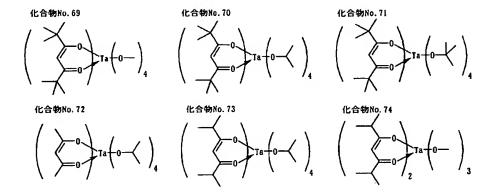
(式中、R^a及びR^bは炭素数 $1\sim1$ 0の有機基を表し、R^cは炭素数 $1\sim5$ のアルキル基を表し、M²はニオプ又はタンタルを表し、R¹及びR²は上記一般式 (I) と同様の基を表し、yは 1、2、3、4又は 5を表し、z は 0、1 又は 2を表す。)

[0037] 上記一般式(VII)及び(VIII)において、R[®]及びR[®]で表される炭素数1~10の有機 基としては、上記一般式(I)のR^Iで例示の基が挙げられ、R[®]で表される炭素数1~5 のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第二ブチル 、第三ブチル、イソブチル、アミル、イソアミル、第二アミル、第三アミルが挙げられる。 上記一般式(VII)で表される化合物の具体例としては、下記化合物No. 52~74が 挙げられる。

[0038] [化13]

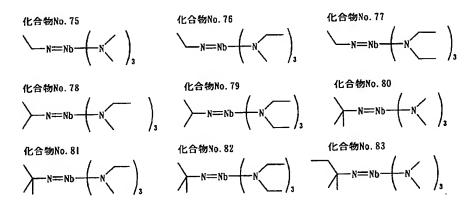
[0039] [化14]

[0040] [化15]

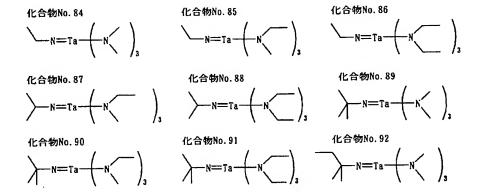


[0041] 上記一般式(VIII)で表される化合物の具体例としては、下記化合物No. 75~92 が挙げられる。

[0042] [化16]



[0043] [化17]



[0044] 本発明に係るプレカーサとして用いることができるダブルアルコキシド型プレカーサとしては、例えば下記一般式(IX)で表される化合物が挙げられる。

[0045] [化18]

$$M^3M_D^4 + OR^1)_Q + OR^d)_{\Gamma} \qquad (IX)$$

(式中、 R^d は炭素数 $1\sim 10$ の有機基を表し、 R^1 は上記一般式 (I) と同様の基を表し、 M^3 及び M^4 は少なくともどちらか一方はチタニウム、ジルコニウム、ハフニウム、ニオプ又はタンタルを表し、他方は金属原子を表し、pは1又は2を表し、q+rは分子中に含まれる金属原子 M^3 及び金属原子 M^4 の価数の総和を示す。)

[0046] 上記一般式(IX)において、R^dで表される炭素数1~10の有機基としては、R¹で例示の基が挙げられ、M³及びM⁴で表される金属原子としては、前記[0013]に例示のものが挙げられる。上記一般式(IX)で表される化合物の具体例としては、下記化合物No. 93~115が挙げられる。

[0047] [化19]

[0048] [化20]

[0049] [化21]

[0050] [化22]

15

- [0051] 本発明の化学気相成長(CVD)用原料は、上記の金属化合物を薄膜のプレカーサ として含有してなるものであり、液相での光散乱式液中粒子検出器によるパーティク ル測定において、0.5 μ mより大きい粒子の数が液相1ml中に100個以下であるこ とを特徴とする。
- [0052] 本発明のCVD用原料の形態は、使用されるCVD法の輸送供給方法等の手法により適宜選択される。輸送供給方法としては、CVD用原料を原料容器中で加熱及び/又は減圧することにより気化させ、必要に応じて用いられるアルゴン、窒素、ヘリウム等のキャリアガスと共に堆積反応部へと導入する気体輸送法、CVD用原料を液体又は溶液の状態で気化室まで輸送し、気化室で加熱及び/又は減圧することにより気化させて、堆積反応部へと導入する液体輸送法がある。気体輸送法の場合は、プレカーサである金属化合物そのものがCVD用原料となり、液体輸送法の場合は、プレカーサである金属化合物そのもの又はプレカーサを有機溶剤に溶かした溶液がCVD用原料である。
- [0053] また、多成分系のCVD法においては、CVD用原料を各成分独立で気化、供給する方法(以下、シングルソース法と記載することもある)と、多成分原料を予め所望の組成で混合した混合原料を気化、供給する方法(以下、カクテルソース法と記載することもある)がある。カクテルソース法の場合、金属化合物の混合物、或いは2種以上の金属化合物を有機溶剤に溶かした混合溶液がCVD用原料である。
- [0054] 従って、本発明のCVD用原料における液相の状態とは、次の2つの場合を指す。

1つは、金属化合物そのもの或いは金属化合物の混合物の場合である。この場合は CVD法においてCVD用原料を液体で輸送供給する温度域での液体状態であり、 その温度は通常150℃以下である。もう1つは、1種又は2種以上の金属化合物を有機溶剤に溶かした溶液の状態である。通常、該溶液を用いる溶液供給法は、融点の高い金属化合物をプレカーサに使用する場合や金属化合物の混合物をプレカーサに使用する場合に選択される。

溶液供給法の場合のCVD用原料に使用する有機溶剤としては、特に制限を受け [0055] ることはなく周知一般の有機溶剤を用いることが出来る。該有機溶剤としては、例え ば、メタノール、エタノール、2ープロパノール、nーブタノール等のアルコール類;酢 酸エチル、酢酸ブチル、酢酸メトキシエチル等の酢酸エステル類;エチレングリコー ルモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル等のエーテルアルコ ール類:テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、エチレングリコールジメチルエーテル、 ジエチレングリコールジメチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエーテル、ジ ブチルエーテル、ジオキサン等のエーテル類;メチルブチルケトン、メチルイソブチル ケトン、エチルブチルケトン、ジプロピルケトン、ジイソブチルケトン、メチルアミルケト ン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン等のケトン類;ヘキサン、シクロヘキサン 、メチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ヘプタン、 オクタン、トルエン、キシレン等の炭化水素類;1ーシアノプロパン、1ーシアノブタン、 1ーシアノヘキサン、シアノシクロヘキサン、シアノベンゼン、1,3ージシアノプロパン 、1,4-ジシアノブタン、1,6-ジシアノヘキサン、1,4-ジシアノシクロヘキサン、1 , 4-ジシアノベンゼン等のシアノ基を有する炭化水素類;ピリジン、ルチジンが挙げ られ、これらは、溶質であるプレカーサの溶解性、使用温度と沸点、引火点の関係等 により、単独で又は二種類以上の混合溶媒として用いられる。これらの有機溶剤を使 用する場合、該有機溶剤中におけるプレカーサの合計量が0.01~2.0モル/リット ル、特に0.05~1.0モル/リットルとなるようにするのが好ましい。

[0056] また、本発明のCVD用原料には、必要に応じて、プレカーサに安定性を付与する ため、求核性試薬を含有させてもよい。該求核性試薬としては、グライム、ジグライム

- [0057] 本発明のCVD用原料は、液相での光散乱式液中粒子検出器によるパーティクル 測定において、0.5μmより大きい粒子の数が液相1ml中に100個以下であり、0.3 μmより大きい粒子の数が100個以下であることが好ましく、さらに、0.2μmより大き い粒子の数が液相1ml中に1000個以下、特に100個以下であることが好ましい。
- [0058] 本発明のCVD用原料の液相でのパーティクル測定は、光散乱式液中粒子測定方法によるものであり、レーザを光源とした市販の測定装置を利用して測定できる。測定に関しては、測定の前に測定系のCVD用原料が接触する配管、バルブ等の部材の水分を充分に涸らすために真空加熱乾燥を行うことが好ましい。
- [0059] 本発明のCVD用原料は、その製造方法については特に制限を受けず、常法に準じて製造することができる。本発明のCVD用原料は、例えば、金属化合物、必要に応じて用いられる有機溶剤や求核性試薬、充填及びパージ等に使用する不活性ガス等の使用する原材料について充分に精製及び脱水を行うと共に、製造装置及び精製装置は清浄化を行ったものを用い、更に、製造工程中に、適正な材質や規格の

フィルターを用いた濾過工程を組み入れることにより得ることができる。

- [0060] 金属化合物の精製においては、金属化合物が、不純物金属元素分、不純物塩素等のハロゲン分、有機物不純物を極力含まないようにする。不純物金属元素分は、元素毎では100ppb以下が好ましく、10ppb以下がより好ましく、総量では1ppm以下が好ましく、100ppb以下がより好ましい。不純物塩素等のハロゲン分は、100ppm以下が好ましく、10ppm以下がり好ましく、1ppm以下が更に好ましい。有機不純物は、総量で500ppm以下が好ましく、50ppm以下が好ましく、10ppm以下がより好ましい。また、水分はCVD用原料中のパーティクル発生やCVD法によるパーティクル発生の原因となるので、金属化合物、有機溶剤及び求核性試薬については、それぞれの水分の低減のために、使用の際には予めできる限り水分を取り除いたほうがよい。金属化合物、有機溶剤及び求核性試薬それぞれにおいて、水分量は10ppm以下が好ましく、1ppm以下がより好ましい。
- [0061] 上記の濾過工程に使用されるフィルターの材質は、セルロース、PTFE樹脂等の有機材質でもよく、ステンレス基材に代表される金属、ガラスファイバー、石英、珪藻土、セラミックス等の無機材質でもよい。また、液体用のフィルターだけではなく、ガス用のフィルターを用いてもよい。フィルターの規格は、濾過精度において、1 μ m~0.0 001 μ mの範囲のものが好ましい。
- [0062] また、上記フィルターは、1種類で使用してもよく、又は2種類以上組み合わせて使用してもよい。フィルターを組み合わせて使用する場合は、例えば、PTFE樹脂等の有機材質フィルターを一次又は低次フィルターとし、石英や金属等の無機材質フィルターを二次又は高次フィルターとする方法、濾過精度の低いフィルターを低次フィルターとし、濾過精度の高いフィルターを高次フィルターとする方法、これらの方法を組み合わせる方法等を採用することができる。特にSUS系金属材質のガス用フィルターは、アウトガスが少なく、フィルター中の水分を除去することが容易であるので、これを高次フィルターとすることで、生産性を低下させることなく本発明のCVD用原料を製造することができる。また、CVD用原料のフィルター通過流量や圧力等の濾過条件についても、特に制限を受けず、CVD用原料に対して適切な値を選択すればよい。

- [0063] 本発明の金属含有薄膜の製造方法は、本発明のCVD用原料を用い、これを気化させた蒸気及び必要に応じて用いられる反応性ガスを基板上に導入し、次いで、プレカーサを基板上で分解及び/又は反応させて薄膜を基板上に成長、堆積させるCVD法によるものである。原料の輸送供給方法、堆積方法、製造条件、製造装置等については、特に制限を受けるものではなく、周知一般の条件、方法等を用いることができる。
- [0064] 上記の必要に応じて用いられる反応性ガスとしては、例えば、酸化性のものとしては、酸素、オゾン、二酸化窒素、一酸化窒素、水蒸気、過酸化水素、ギ酸、酢酸、無水酢酸等が挙げられ、還元性のものとしては、水素が挙げられ、また、窒化物を製造するものとしては、モノアルキルアミン、ジアルキルアミン、トリアルキルアミン、アルキレンジアミン等の有機アミン化合物、ヒドラジン、アンモニア等が挙げられる。
- [0065] また、上記の輸送供給方法としては、前記に記載した気体輸送法、液体輸送法、シングルソース法、カクテルソース法等が挙げられる。
- [0066] また、上記の堆積方法としては、原料ガス、又は原料ガス及び反応性ガスを、熱のみにより反応させ薄膜を堆積させる熱CVD、熱及びプラズマを使用するプラズマCVD、熱及び光を使用する光CVD、熱、光及びプラズマを使用する光プラズマCVD、CVDの堆積反応を素過程に分け、分子レベルで段階的に堆積を行うALD(Atomic Layer Deposition)が挙げられる。
- [0067] また、上記の製造条件としては、反応温度(基板温度)、反応圧力、堆積速度等が 挙げられる。反応温度については、本発明に係る金属化合物が充分に反応する温 度である150℃以上が好ましく、200~800℃がより好ましい。また、反応圧力は、熱 CVD又は光CVDの場合、大気圧~10Paが好ましく、プラズマを使用する場合は、 10~2000Paが好ましい。また、堆積速度は、原料の供給条件(気化温度、気化圧 力)、反応温度、反応圧力によりコントロールすることが出来る。堆積速度は、大きいと 得られる薄膜の特性が悪化する場合があり、小さいと生産性に問題を生じる場合が あるので、0.5~5000nm/分が好ましく、1~1000nm/分がより好ましい。また、 ALDの場合は、所望の膜厚が得られるようにサイクルの回数でコントロールされる。
- [0068] また、本発明の金属含有薄膜の製造方法においては、薄膜堆積の後に、より良好

な電気特性を得るために、不活性雰囲気下、酸化性雰囲気下又は還元性雰囲気下でアニール処理を行ってもよく、段差埋め込みが必要な場合には、リフロー工程を設けてもよい。この場合の温度は、好ましくは400~1200℃であり、500~800℃がさらに好ましい。

[0069] 本発明のCVD用原料を用いた本発明の金属含有薄膜の製造方法により製造される薄膜は、金属、合金、酸化物セラミックス、窒化物セラミックス、炭化物セラミックス等の所望の種類の薄膜とすることができる。これらの薄膜の用途としては、高誘電キャパシタ膜、ゲート絶縁膜、ゲート膜、強誘電キャパシタ膜、コンデンサ膜、バリア膜等の電子部品部材、光ファイバ、光導波路、光増幅器、光スイッチ等の光学ガラス部材等が挙げられる。

実施例

- [0070] 以下、実施例、比較例及び評価例をもって本発明を更に詳細に説明する。しかしながら、本発明は以下の実施例等によって何ら制限を受けるものではない。
- [0071] [実施例1]CVD用原料No. 1の製造

下記に示す条件にて、図1に示す装置を用い、化合物No. 8からなるプレカーサについてパーティクル除去を行い、CVD用原料No. 1を得た。

(条件)

フィルターA:ハウジング;PFA、フィルター;PTFE、有効濾過面積;0.07cm 2 、定格濾過精度(液)0.1 μ m

フィルターB:未使用

濾過速度:10ml/min

[0072] [実施例2]CVD用原料No. 2の製造

下記に示す条件にて、図1に示す装置を用い、化合物No. 8からなるプレカーサについてパーティクル除去を行い、CVD用原料No. 2を得た。

(条件)

フィルターA:ハウジング; PFA、フィルター; PTFE、有効濾過面積 $0.07m^2$ 、定格濾過精度(液) 0.1μ m

フィルターB:ハウジングSUS-316L、フィルター;SUS-316L、有効濾過面積3.

14cm²、定格濾過精度(ガス)0.003 μ m

濾過速度:10ml/min

[0073] [実施例3]CVD用原料No. 3の製造

下記に示す条件にて、図1に示す装置を用い、化合物No. 51からなるプレカーサ についてパーティクル除去を行い、CVD用原料No. 3を得た。

(条件)

フィルターA:未使用

フィルターB:ハウジングSUS-316L、フィルター;SUS-316L、有効濾過面積43 $.8cm^2$ 、定格濾過精度(ガス)0.003 μ m

濾過速度:10ml/min

[0074] [実施例4]CVD用原料No. 4の製造

下記に示す条件にて、図1に示す装置を用い、化合物No. 51からなるプレカーサ についてパーティクル除去を行い、CVD用原料No. 4を得た。

(条件)

フィルターA:ハウジング; PFA、フィルター; PTFE、有効濾過面積 $0.07m^2$ 、定格濾過精度(液) $0.1\mu m$

フィルターB:ハウジングSUS-316L、フィルター;SUS-316L、有効濾過面積7.

54cm²、定格濾過精度0.003μm

濾過速度:10ml/min

[0075] 「実施例5]CVD用原料No. 5の製造

下記に示す条件にて、図1に示す装置を用い、化合物No. 5からなるプレカーサについてパーティクル除去を行い、CVD用原料No. 5を得た。

(条件)

フィルターA:ハウジング;PFA、フィルター;PTFE、有効濾過面積 $0.07m^2$ 、定格濾過精度(液) 0.1μ m

フィルターB:ハウジングSUS-316L、フィルター;SUS-316L、有効濾過面積3.

14cm²、定格濾過精度(ガス)0.003μm

濾過速度:10ml/min

[0076] 「実施例6]CVD用原料No. 6の製造

下記に示す条件にて、図1に示す装置を用い、化合物No. 89からなるプレカーサ についてパーティクル除去を行い、CVD用原料No. 6を得た。

(条件)

フィルターA:ハウジング;PFA、フィルター;PTFE、有効濾過面積 $0.07m^2$ 、定格濾過精度(液) 0.1μ m

フィルターB:ハウジングSUSー316L、フィルター;SUSー316L、有効濾過面積3. 14cm^2 、定格濾過精度(ガス)0. $003\,\mu\,\text{m}$

濾過速度:10ml/min

[0077] [実施例7]CVD用原料No. 7の製造

下記に示す条件にて、図1に示す装置を用い、化合物No. 110からなるプレカーサについてパーティクル除去を行い、CVD用原料No. 8を得た。

(条件)

フィルターA:ハウジング;PFA、フィルター;PTFE、有効濾過面積 $0.07m^2$ 、定格濾過精度(液) $0.1\mu m$

フィルターB:ハウジングSUS-316L、フィルター;SUS-316L、有効濾過面積43 $.8 \text{cm}^2$ 、定格濾過精度(ガス)0.003 μ m

濾過速度:10ml/min

[0078] [実施例8]CVD用原料No. 8の製造

下記に示す条件にて、図1に示す装置を用い、トリメチルアルミニウムからなるプレカーサについてパーティクル除去を行い、CVD用原料No. 8を得た。

(条件)

フィルターA:ハウジングSUS-316L、フィルター;SUS-316L、有効濾過面積43 $.8 \text{cm}^2$ 、定格濾過精度(ガス)0.05 μ m

濾過速度:10ml/min

フィルターB:ハウジングSUS-316L、フィルター;SUS-316L、有効濾過面積3. $14cm^2$ 、定格濾過精度(ガス)0.003 μ m

濾過速度:10ml/min

[0079] [実施例9]CVD用原料No. 9の製造

下記に示す条件にて、図1に示す装置を用い、ビス(2, 2, 6, 6ーテトラメチルヘプタン-3, 5ージオナト)鉛;1モル部、化合物No. 3;0. 5モル部、及び化合物No. 5;0. 5モル部のオクタン溶液ソース(オクタン含有量75質量%)からなるプレカーサについてパーティクル除去を行い、CVD用原料No. 9を得た。

(条件)

フィルターA:ハウジング;PFA、フィルター;PTFE、有効濾過面積 $0.07m^2$ 、定格濾過精度(液) 0.1μ m

フィルターB:ハウジングSUS-316L、フィルター;SUS-316L、有効濾過面積7. 54cm^2 、定格濾過精度(ガス)0.003 μ m

濾過速度:10ml/min

[0080] [評価例]パーティクルの測定

下記に示す条件1及び2それぞれにて、図2に示す光散乱式液中粒子測定装置を用いて、上記の実施例1~9で得たCVD用原料及び比較例1、2のCVD用原料について、パーティクル測定を行った。結果を表1に示す。

(条件1)

検出粒子:>0.5μm

光散乱式液中粒子測定装置:KS-40B(リオン社製)

最大定格粒子濃度:1200pcs/ml(0.5 μ m粒子の計数損失5%)

検出限界:0.1個/ml

測定流量:10ml/min

(条件2)

検出粒子:>0.2 μ m及び>0.3 μ m

光散乱式液中粒子測定装置:KS-28E(リオン社製)

最大定格粒子濃度:1200pcs/ml(検出最小粒子の計数損失5%)

検出限界:0.1個/ml

測定流量:10ml/min

[0081] [表1]

CVD 用原料	>0.5 μ m (pcs/ml)	$>0.3 \mu$ m (pcs/ml)	>0.2 \mu m (pcs/ml)
実施例1; CVD 用原料 No.1	検出限界以下	3.9	506
実施例2; CVD 用原料 No.2	77	3.0	6.2
実施例3; CVD 用原料 No.3	40.8	1200 超	1200 超
実施例4; CVD 用原料 No.4	検出限界以下	8.6	41.8
実施例 5; CVD 用原料 No.5	n	4.8	8.2
実施例 6; CVD 用原料 No.6	,,,	3.6	7.5
実施例7; CVD 用原料 No.7	n	4.0	7.7
実施例8; CVD 用原料 No.8	"	5.3	18.8
実施例 9; CVD 用原料 No.9	"	1.2	2.9
比較例1;化合物 No. 8	172	1200 超	1200 超
比較例 2 ; 化合物 No.51	817	1200 超	1200 超

比較例は、フィルターを通過する前の金属化合物を測定したものである。

[0082] [実施例10]酸化ハフニウム薄膜の製造

上記実施例3で得たCVD用原料No. 3を用いて、図3に示すCVD装置により、以下の条件及び工程で酸化ハフニウム薄膜を製造した。得られた薄膜について、0.1 ~ 0.3μ mのパーティクルを暗視式ウエーハ異物検査装置により測定した。測定結果を以下に示す。

(条件)

反応温度(基板温度);200℃、反応性ガス;酸素/オゾン(モル)=1/1 (工程)

下記(1)~(4)からなる一連の工程を1サイクルとして、80サイクル繰り返し、最後に5 00℃で3分間アニール処理を行った。

- (1)気化室温度150℃、気化室圧力2000~2200Paの条件で気化させたCVD用原料の蒸気を導入し、系圧2000~2200Paで2秒間堆積させる。
- (2)3秒間のアルゴンパージにより、未反応原料を除去する。
- (3)反応性ガスを導入し、系圧力1300Paで2秒間反応させる。
- (4)2秒間のアルゴンパージにより、未反応原料を除去する。

(結果)

パーティクル数:1.16個/平方インチ

[0083] [実施例11]酸化ハフニウム薄膜の製造

上記実施例4で得たCVD用原料No. 4を用いた以外は、上記実施例10と同様の 方法を用いて、酸化ハフニウム薄膜を製造し、得られた薄膜についてパーティクルを 測定した。

(結果)

パーティクル数:0.11個/平方インチ

[0084] [比較例3]酸化ハフニウム薄膜の製造

CVD用原料として上記表1に記載の比較例2のCVD用原料を用いた以外は、上記実施例10と同様の方法を用いて、酸化ハフニウム薄膜を製造し、得られた薄膜についてパーティクルを測定した。

(結果)

パーティクル数:14.4個/平方インチ

産業上の利用可能性

[0085] 本発明によれば、パーティクルを低減したCVD用原料を提供でき、このCVD原料を使用することで、パーティクル汚染が抑制された薄膜を製造することができる。また、本発明によれば、このCVD原料を使用した薄膜の製造方法を提供することができる。

請求の範囲

- [1] 金属化合物からなるプレカーサを含有してなり、液相での光散乱式液中粒子検出 器によるパーティクル測定における0.5 μ mより大きい粒子の数が1ml中100個以下 である化学気相成長用原料。
- [2] 光散乱式液中粒子検出器によるパーティクル測定における0.3 μ mより大きい粒子の数が1ml中100個以下である請求の範囲第1項に記載の化学気相成長用原料
- [3] 光散乱式液中粒子検出器によるパーティクル測定における0.2 μ mより大きい粒子の数が1ml中1000個以下である請求の範囲第1又は2項に記載の化学気相成長用原料。
- [4] 光散乱式液中粒子検出器によるパーティクル測定における0.2 μ mより大きい粒子の数が1ml中100個以下である請求の範囲第3項に記載の化学気相成長用原料
- [5] 上記プレカーサが、下記一般式(I)で表される基が金属原子に結合した構造を有する金属化合物からなる請求の範囲第1~4項のいずれかに記載の化学気相成長用原料。

[化1]

$$-\frac{R^1}{1-(-R^2)_n}$$
 (1)

(式中、Xは、酸素原子又は窒素原子を表し、nは、Xが酸素原子の場合は0を表し、Xが窒素原子の場合は1を表し、 R^1 は、炭素数 $1\sim 1$ 0の有機基を表し、 R^2 は、水素原子又は炭素数 $1\sim 1$ 0の有機基を表す。)

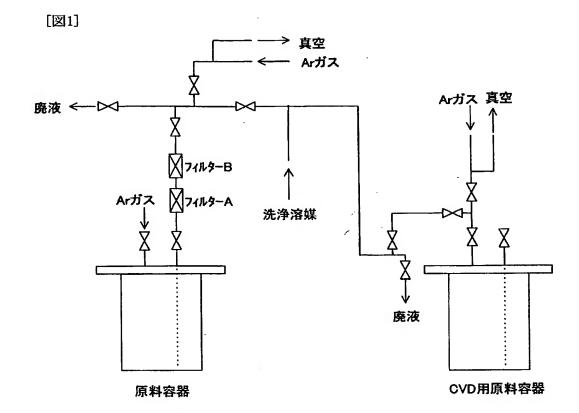
[6] 上記プレカーサが、下記一般式(II)で表される基が金属原子に結合した構造を有する金属化合物からなる請求の範囲第1~4項のいずれかに記載の化学気相成長用原料。

[化2]

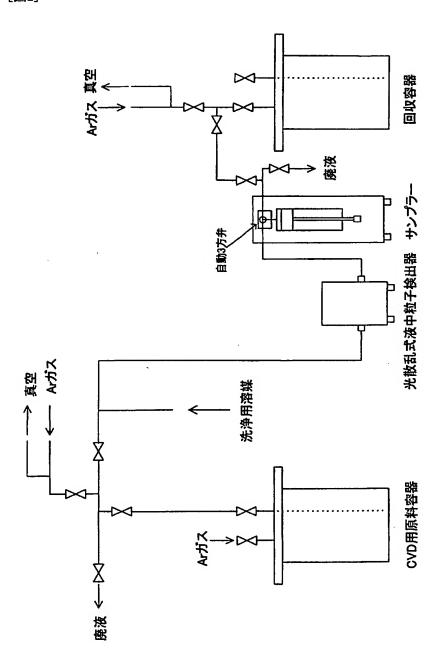
 $--R^3 \qquad (11)$

(式中、 R^3 は、炭素数 $1\sim 8$ のアルキル基又は炭素数 $1\sim 1$ 0 のシクロペンタジエニル基を表す。)

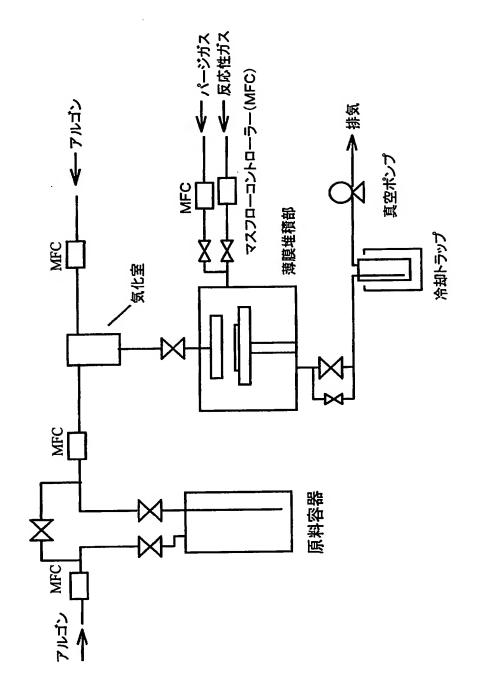
- [7] 上記金属化合物が、アルミニウム化合物、チタニウム化合物、ジルコニウム化合物、 ハフニウム化合物、タンタル化合物及びニオブ化合物から選ばれるものである請求 の範囲第1~6項のいずれかに記載の化学気相成長用原料。
- [8] 上記金属化合物が、ハフニウム化合物である請求の範囲第7項に記載の化学気相成長用原料。
- [9] 液相で輸送又は供給されるものである請求の範囲第1~8項のいずれかに記載の 化学気相成長用原料。
- [10] 請求の範囲第1~9項のいずれかに記載の化学気相成長用原料を用いた化学気相成長法による金属含有薄膜の製造方法。



[図2]



[図3]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/008145

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C23C16/40, H01L21/316					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SE					
	entation searched (classification system followed by class C23C16/40, H01L21/316	ssification symbols)			
Jitsuyo Kokai Ji	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) JSTPlus (JOIS)					
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X Y	JP 2002-155008 A (Kojundo Chemical Laboratory Co., Ltd.), 28 May, 2002 (28.05.02), Par. Nos. [0002], [0018] to [0021] (Family: none)		1-4,10 5-9		
Y	JP 2002-60944 A (International Business Machines Corp.), 28 February, 2002 (28.02.02), Claims; Par. Nos. [0075] to [0096] & KR 2001098415 A		5-9		
× Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" document of to be of part "E" earlier applifiling date "L" document we cited to esta special rease "O" document re the priority of the priority of the actual contents of the actua	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "E" step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document with one or more other such documents, such combined with one		cation but cited to understand invention claimed invention cannot be dered to involve an inventive claimed invention cannot be step when the document is a documents, such combination e an family		
	y, 2005 (29.07.05)	23 August, 2005 (2:	3.08.05)		
	Vame and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer		ļ		
Facsimile No.		Telephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2005/008145

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	2005/008145
-	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y Y	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages JP 2004-104111 A (Samsung Electronics Co., Ltd.), 02 April, 2004 (02.04.04), Claims; example 5 & EP 1394164 Al & CN 1482653 A & KR 2004015428 A & US 2004/113195 Al	Relevant to claim No. 5,7-9
	· *	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.7 C23C16/40, H01L21/316

調査を行った分野 B.

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.7 C23C16/40, H01L21/316

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

JSTPlus (JOIS)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	.関連する 請求の範囲の番号		
X	JP 2002-155008 A (株式会社高純度化学研究所) 2002.05.28 [0002], [0018]-[0021], (ファミリーなし)	1-4,10 5-9		
Y	JP 2002-60944 A (インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション) 2002.02.28, 特許請求の範囲, [0075]-[0096], & KR 2001098415 A	5-9		
Y	JP 2004-104111 A (三星電子株式会社) 2004.04.02 特許請求の範囲, 実施例5, & EP 1394164 A1, & CN 1482653 A, & KR 2004015428 A, & US 2004/113195 A1	5,7-9		

「 C欄の続きにも文献が列挙されている。

「 パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献 (理由を付す)
- 「O」、口頭による開示、使用、展示等に官及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

29, 07, 2005

国際調査報告の発送日

23. 8. 2005

国際調査機関の名称及びあて先

特許庁審査官(権限のある職員)

9278 4 G

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4番3号

電話番号 03-3581-1101 内線 3416